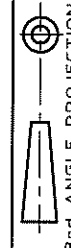


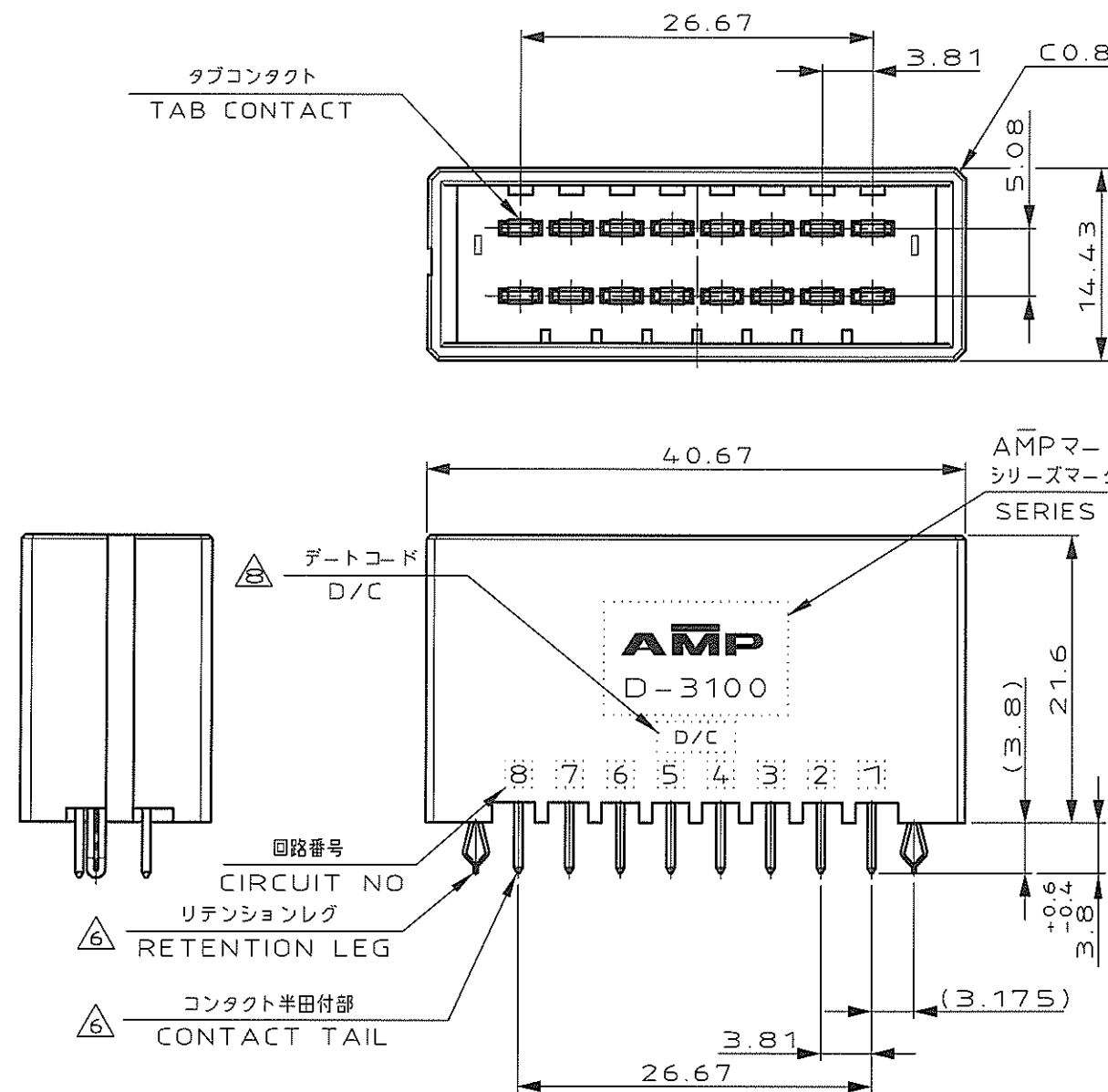
PRINT DIST
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

METRIC



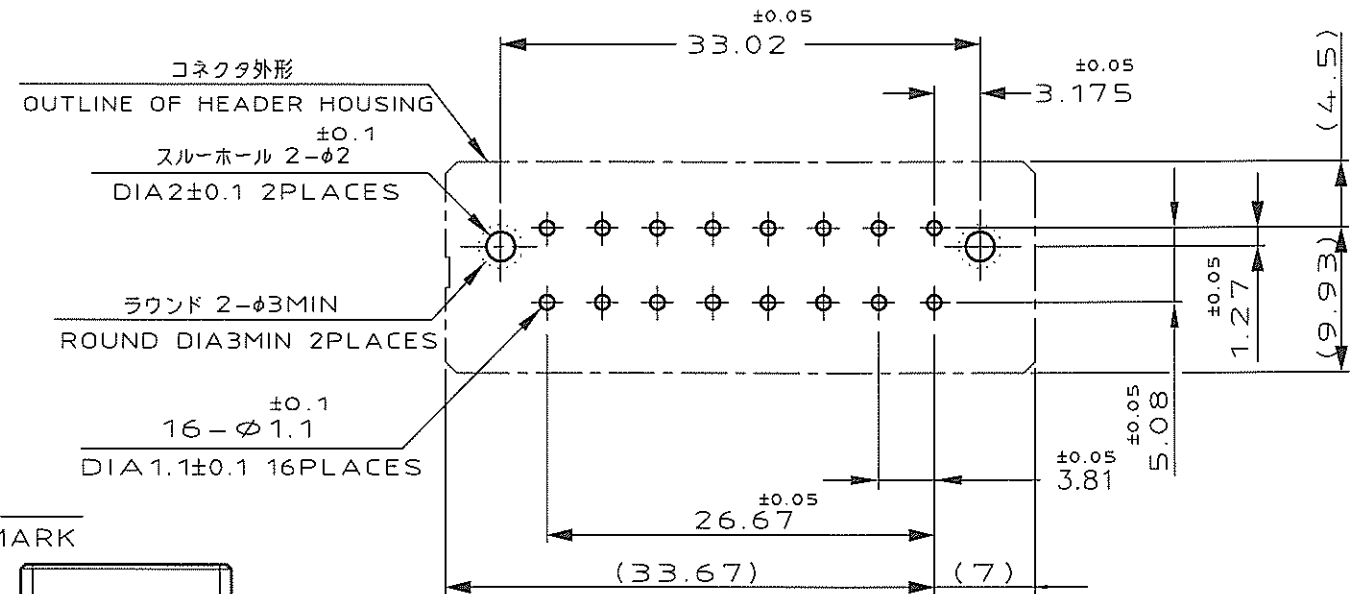
NUMBER

178327



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μ m MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μ m MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μ m MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
7. THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
8. THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
2. リテンションレグ: 銅合金
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μ m MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μ m MIN金めっき
5. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μ m MINスズめっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
7. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき
7. 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
8. 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

6	4	178327-5
6	3	178327-3
6	2	178327-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	20MAR 11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

			 TE Connectivity		
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME 16 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
mm ² (AWG) -		- mm ²			
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 19 APR 94 N. Matsubara		DE. 19 APR 94 N. Matsubara		SIZE A3	
CHK. 20 APR 94 S. MANABE		APP. 20 APR 94 S. MANABE		LOC J	
				NUMBER C-178327	
				SCALE 2-1	
				REV. E2	
				SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面